

2019 年度学会発表

1. 国際学会発表(ポスター含む)

- 1) Shun Ishikawa, Katsuhiko Tashiro, Hideo Honma and Hiroaki Kouzai
“Relationship between Deposition Rate and Film Composition of Electroless Ni-Sn-P Plating”
MSST 2019, The 8th International Symposium on Materials Science and Surface Technology 2019
No. PA-07, December 9, 2019, Kanto Gakuin University, Japan
- 2) Yasuhiro Oi, Senketsu Shin, Hiroaki Kouzai, Mitsuhiro Watanabe, Katsuhiko Takeda, Keiichiro Sano
“Plating Method of ABS Resin Added Bamboo Fiber for Low Environmental Impact “
The 8th International Symposium on Materials Science and Surface Technology 2019, PA01, Dec.9, 2019.12, Kanto Gakuin University Kannai Media Center, Yokohama, Japan
- 3) Shinya Tako, Tomofumi Mochizuki, Masahiro Nakayama, Yohei Kotsuchibashi, Katsuhiko Tashiro, Hideo Honma, Osamu Takai
“Generation of Hydrophobic Effect on Nickel 3D Structure by Electroplating”
Materials Research Meeting 2019, Dec.11, 2019, Yokohama, Japan
- 4) Toshiro Okawa, Ian Thomas Clark, Katsuhika Tashiro, Hideo Honma, Kazuhiro Yoshihara, Osamu Takai
“Orientation Dependence of Hardness of Single Crystal Sapphire Surface Measured by Nanoindentation”
The 8th International Symposium of Materials Science and Surface Technology 2019, PA05, Dec. 9, 2019, KGU kannai Media Center, Kanagawa
- 5) Toshiro Okawa, Katsuhika Tashiro, Hideo Honma, Osamu Takai
“The Hardness of Single Crystal Sapphire under Controlled High Temperature”
Materials Research Meeting 2019, H1-11-008, Dec. 11, 2019, Yokohama Symposia & Yamashita Park District, Kanagawa
- 6) Y. Suzuki, Y. Umeda, C.E.J.Cordonier, H. Honma, O. Takai, J.H Noh
“Physical Properties of Deposits and Three-Dimensional Structures Prepared by High-Speed Electrolytic Copper Plating Using a Jet Flow Device”
236th ECS Meeting (Atlanta, America)
F01-0995, Oct. 15, 2019
- 7) Yohei Suzuki, Yasushi Umeda, C.E.J.Cordonier, Hideo Honma, Osamu Takai, Joo-Hyong Noh
“Fabrication of Three-Dimensional Structure by High-Speed Copper Sulfate Plating”
Materials Research Meeting 2019
H1-12-O09, p.226, Dec. 12, 2019
- 8) Yohei Suzuki, Yasushi Umeda, Toshinosuke Akutsu, Christopher E.J.Cordonier, Osamu Takai, Joo-Hyong Noh
“High-Speed Filling Plating on Line / Via Patterns Mixed Substrate”
The 8th International Symposium on Materials Science and Surface Technology 2019
PA-09, p.30, Dec. 9, 2019
- 9) Tatsuki Suzuki, Kouta Kamei, Hideo Honma, Mitsuhiro Watanabe
“Formation of nickel film by electroless plating using copper catalyst”
MSST 2019, The 8th International Symposium on Materials Science and Surface Technology 2019 , PA-10, December 9th, 2019, KGU Kannai Media Center, Yokohama, Japan
- 10) Eri Akisawa, Yohei Suzuki, Yasushi Umeda, Toshinosuke Akutsu, Osamu Takai and Hiroaki Kouzai ,
“High-Speed Electro Nickel Plating with acetic acid”,
MSST 2019, The 8th International Symposium on Materials Science and Surface Technology 2019,PA-6
December 9th, 2019, KGU Kannai Media Center, Yokohama, Japan

- 11) Toshinosuke Akutsu, Youhei Suzuki, Yasushi Umeda,
 "CFD analysis of flow field inside the high speed plating chamber: Influence of inlet nozzle and outlet drain arrangement on bath solution temperature distribution simulating material diffusion",
MSST2019, The 8th International Symposium on Materials Science and Surface Technology 2019, PA-02, December 9th, 2019, KGU Kannai Media Center, Yokohama, Japan
- 12) Jong Young Park, Byeong Choi, Joo-Hyong Noh, Hideo Honma, Osamu Takai
 "Study on Flash Lamp Annealing Solution for Advanced Package",
10th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019), B-06 (2019)
- 13) Changmyeon Lee, Hongkee Lee, Hideo Honma, Osamu Takai, Joo-Hyong Noh, Jun-mi Jeon
 "Lithium Plating Process for Anode Production for Next-generation Secondary Battery with High Energy Density ",
10th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019), N-04 (2019)
- 14) Changmyeon Lee, Hongkee Lee, Hideo Honma, Osamu Takai, Joo-Hyong Noh, Seok-Bon Koo, Jin-Young Hur
 "Aging Effect of Adhesion Strength Between Polyimide Film and Copper Layer ",
10th International Conference on Materials for Advanced Technologies (ICMAT2019), B-05 (2019)
- 15) Jong-Young Park, Eun-Cheol Ahn, Kang-Seop Youm, Kwan-Sun Yoon, Young-Hwan Shin, Joo-Hyong Noh,, Young-Jae Kim
 "Adhesion Strength and Warpage Behaviors of Advanced Package Substrate by Light-source Irradiation ",
IEEE-21st Electronics Packaging Technology Conference (EPTC 2019), P137 (2019)
- 16) Kaito Seki, Joo-Hyung Noh, Yoshio Horiuchi, Osamu Takai, Hideo Honma, Tomoyoshi Motohiro, Tatsumi Hioki, Minoru Sasaki and Taro Arakawa
 "Copper thin film formation on superconductor material for compact SMES using plating method
The 8th International Symposium on Materials Science and Surface Technology (MSST2019), PA02, pp.17-18 (2019)
- 17) ByeongJae Choi, Jong-Young Park, Joo-Hyong Noh, Hideo Honma
 "Annealing copper thin film plated on dielectric film by Flash Lamp Annealing method ",
The 8th International Symposium on Materials Science and Surface Technology (MSST2019), PA04, pp.21-23 (2019)
- 18) Changmyeon Lee, Hongkee Lee, Hideo Honma, Osamu Takai, Joo-Hyong Noh, Jun-mi Jeon
 "Study on Aging Effect of Adhesion Strength between Polyimide Film and Copper Layer",
Materials Research Meeting 2019 (MRM 2019), H1-11-P40 (2019)
- 19) Jong Young Park, Byeong Choi, Hideo Honma, Joo-Hyong Noh
 "Flash Lamp Annealing Effect on low-dielectric thin film ",
Materials Research Meeting 2019 (MRM 2019), H1-11-P42 (2019)
- 20) Jong Young Park, Young-Jae Kim, Hideo Honma, Joo-Hyong Noh
 "Surface Modification of Di-Electric Material using Photo Pretreatment",
Materials Research Meeting 2019 (MRM 2019), H1-12-O10 (2019)
- 21) Tomoyoshi Motohiro, Minoru Sasaki, Joo-hyong Noh, Osamu Takai, Hideo Honma
 "Estimatin of Electricity Storage Density of Compact SMESs Composed of Stacks of Si-wafers Loaded with Superconducting Thin Film Coils in Spiral Trenches formed by MEMS Process under the Constraint of Critical Magnetic Flux Density ",
The 32nd International Symposium on Semiconductivity (ISS 2019), PCP-1 (2019)

2. 国内学会発表(ポスター含む)

- 1) 石川 駿, 田代雄彦, 本間英夫, 高井 治, 香西博明
“高耐食性を有する無電解 Ni-Sn-P めっきの開発”,
第 140 回表面技術協会講演大会, p.167(2019 年 9 月) 福岡工業大学
- 2) 石川 駿, 田代雄彦, 本間英夫, 高井 治, 香西博明
“高耐食性無電解 Ni-Sn-P めっきの開発”, 化学系学協会北海道支部 2020 年冬季研究発表会
講演番号 1C01 2020 年 1 月 28 日北海道大学学術交流会館
- 3) 曾維順, 田代雄彦, 石川駿, 堀内義夫, 梅田泰, 本間英夫, 高井治
“三元系フッ素ゴムへのメタライジング”
化学系学協会北海道支部 2020 年冬季研究発表会, pp. C102(2020.1) 北海道大学, 北海道
- 4) 大井康寛, 深井晶央, 小杉信明, 八木田浩史, 香西博明, 佐野慶一郎
“自動車プラスチックのリサイクル手法による LCA”
自動車技術会 2019 年春季大会学術講演会 (2019.5) パシフィコ横浜会議センター, 神奈川
- 5) 大井康寛, 仲田 智, 八木田浩史, 武田克彦, 佐野慶一郎
“自動車の環境影響評価に関する研究”
自動車技術会 2019 年秋季大会学術講演会 (2019.10) 仙台国際センター, 宮城
- 6) 大井康寛, 秦 占杰, 八木田浩史, 香西博明, 渡邊充広, 武田克彦, 佐野慶一郎
“竹繊維を添加した自動車用プラスチック材料の環境影響評価”
第 15 回日本 LCA 学会研究発表会 (2020.3) 武藏野大学有明キャンパス, 東京
- 7) 望月智文, 田光伸也, 仲山昌宏, 小土橋陽平, 田代雄彦, 本間英夫
“塩化ニッケル浴による凹凸構造の作製及び疎水性皮膜への応用”
表面技術協会第 141 回講演大会, p.102(2020 年 3 月) 首都大学東京・南大沢キャンパス
- 8) 大川登志郎, クラーク・トマス・イアン, 田代雄彦, 吉原一紘, 本間英夫, 高井治
“ナノインデンテーション法による単結晶サファイアの機械特性評価”
第 140 回表面技術協会講演大会, p.117 (2019.9) 福岡工業大学, 福岡
- 9) 細見彰良、古宇田洋行、山下嗣人、高井治、渡邊充広
“回路形状向上のための電析皮膜構造とエッチング液の検討”
2019 年度日本材料科学会学術講演大会 講演 No.45 関東学院大学関内メディアセンター
- 10) 秋澤英里、鈴木陽平、梅田泰、阿久津敏乃介、高井治、香西博明
“有機酸を用いたホウ酸フリー高速ニッケルめっき”
関東学院大学理工・建築学会研究発表講演論文集, pp.46-47 (2019 年 11 月 11 日) 関東学院大学
- 11) 亀井恒汰, 鈴木建輝, 堀内義夫, 本間英夫, 渡邊充広
“UV 改質を用いた回路形成の検討”
表面技術協会第 141 回講演大会, p.109 (2020.03) 首都大学東京・南大沢キャンパス
- 12) 須郷美智子, 梅田 泰, 田代雄彦, 本間英夫, 高井 治
“めっき皮膜と抗菌効果の関係に関する検討”
第 140 回表面技術協会講演大会 p.170 (2019.9) 福岡工業大学
- 13) 鈴木 建輝, 亀井 恒太, 本間 英夫, 渡邊 充広
銅触媒による無電解めっきプロセス

表面技術協会第 141 回講演大会,p.116(2020.3)首都大学東京・南大沢キャンパス

14) 中川直樹 秦泉寺真琴 西村宜幸 福田千紗

“ポーラス型アルミニウム陽極酸化 (AAO) 皮膜のインターポーザへの応用”
実装フェスタ関西 2019 (2019.7) パナソニッククリゾート大阪 大阪府

15) 秋澤英里、鈴木陽平、梅田泰、阿久津敏乃介、高井治、香西博明

”環境に配慮した有機酸を用いた高速ニッケルめっき”

表面技術協会第 140 回講演大会、p.33(2019 年 9 月) 福岡工業大学

16) 細見彰良、古宇田洋行、山下嗣人、高井治、渡邊充広

“回路形状向上のための電析皮膜構造とエッチング液の検討”

2019 年度日本材料科学会学術講演大会、p. 77-78 (2019.5) KGU 関内メディアセンター、神奈川

17) 堀内義夫、高木道則、安井学、渡邊充広、高井治、本間英夫

“選択的表面改質を用いたレジストレス配線パターン形成法”

KISTEC Innovation Hub 2019 in Ebina, 3PS-6 (2019.11) 神奈川県立産業技術総合研究所、神奈川

18) 李 昌勉、李 洪基、本間 英夫、盧 柱亨

“電解めっき法による透明電極の簡易製造法”

表面技術協会第 140 回講演大会、p.163(2019 年 9 月) 福岡工業大学

19) 崔 炳在、朴 鍾永、本間 英夫、盧 柱亨

“FLA による各種樹脂フィルム基板上めっき皮膜の熱処理”

表面技術協会第 140 回講演大会、p.164 (2019 年 9 月) 福岡工業大学

20) 崔 炳在、朴 鍾永、本間 英夫、高井 治、盧 柱亨

“Flash Lamp Annealing (FLA) による各種樹脂フィルム基板上めっき被膜の熱処理”

KISTEC Innovation Hub 2019 (2019年11月)

21) 関 海斗、荒川 太郎、盧 柱亨、元廣 友美、佐々木 実

“めっき法を用いた小型 SMES のための超電導体材料上への銅膜形成”

KISTEC Innovation Hub 2019 (2019年11月)

22) 鎌田大、宮関 勇輔、荒川 太郎、堀内 義夫、盧 柱亨、本間 英夫

“無電解銅めっきを用いた液晶ポリマーへのレジストレスダイレクトパターンニング”

KISTEC Innovation Hub 2019 (2019年11月)

23) 田代雄彦、曾 維順、野村太郎、梅田 泰、本間英夫、高井 治

“クローズド化ファインバブル低濃度オゾン水システムによる ABS 樹脂の表面改質”

表面技術協会第 140 回講演大会、p.157(2019 年 9 月) 福岡工業大学

24) 田代雄彦、曾 維順、石川 駿、堀内義夫、梅田 泰、本間英夫、高井 治

“フッ素系ゴムへ大気 UV 処理を適用した高密着めっき法”

表面技術協会第 140 回講演大会、p.158 (2019 年 9 月) 福岡工業大学

25) 田代雄彦、曾 維順、石川 駿、堀内義夫、梅田 泰、本間英夫、高井 治

“大気 UV 処理によるフッ素系ゴムへのメタライジング”

表面技術協会第 141 回講演大会、p.108 (2020 年 3 月) 首都大学東京・南大沢キャンパス